附件：

讨论的标准项目

| 序号 | 计划文号及编号 | 项目名称 | 主编单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一组 | | | | |
|  | 国标委发[2022]17号20220133-T-469 | 埋层硅外延片 | 南京国盛电子有限公司 | 审定 |
|  | 国标委发[2021]19号  20211956-T-469 | 半导体晶片表面金属沾污的测定 全反射X射线荧光光谱法 | 有研半导体硅材料股份公司 | 审定 |
|  | 工信厅科〔2023〕18号  2023-0001T-YS | 集成电路用四甲基硅烷 | 洛阳中硅高科技有限公司 | 讨论 |
|  | 工信厅科〔2023〕18号  2023-0082T-YS | 半导体材料掺杂用扩散膜 | 安徽安芯电子科技股份有限公司 | 讨论 |
|  | 正在公示  （2023000386） | [半导体晶片直径测试方法](http://zxd.sacinfo.org.cn/gb/gbdetail/loadview?projectId=1013698) | 麦斯克电子材料股份有限公司 | 讨论 |
| 第二组 | | | | |
|  | 工信厅科函[2022]94号  2022-0109T-YS | 硅材料中氢含量的测定 惰性气体熔融热导法 | 江苏中能硅业科技发展有限公司 | 审定 |
|  | 中色协科字[2022]100号  2022-060-T/CNIA | 多晶硅行业清洁生产评价指标体系 | 四川永祥股份有限公司 | 审定 |
|  | 工信厅科函[2022]94号  2022-0250T-YS | 颗粒硅总金属杂质含量的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 江苏中能硅业科技发展有限公司 | 预审 |
|  | 工信厅科函[2022]94号  2022-0470T-YS | 多晶硅生产用石墨制品表面杂质含量的测定 电感耦合等离子体光谱法 | 新疆协鑫新能源材料科技有限公司 | 预审 |
|  | 工信厅科函[2022]312号  2022-2014T-YS | 再生硅料 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 预审 |
|  | 工信厅科〔2023〕18号  2023-0083T-YS | 区熔用多晶硅材料 | 陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司 | 讨论 |
|  | 正在公示  （2023000379） | 太阳能级多晶硅 | 洛阳中硅高科技有限公司 | 讨论 |